

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月19日(19.09.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/190721 A1

(51) 国際特許分類:
B22F 1/00 (2022.01) H01B 1/22 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/009235
(22) 国際出願日: 2024年3月11日(11.03.2024)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
PCT/JP2023/009945 2023年3月14日(14.03.2023) JP

(71) 出願人: 花王株式会社(KAO CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 江山 誉昭(EYAMA Takaaki); 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 花王株式会社内 Tokyo (JP). 稲家 修一(INAYA Shuichi); 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 花王株式会社内 Tokyo (JP). 中川 晴香(NAKAGAWA Haruka); 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 花王株式会社内 Tokyo (JP). 鈴木 佑京(SUZUKI Ukyo); 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 花王株式会社内 Tokyo (JP). 福田 泰紀(FUKUDA Taiki); 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 花王株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎

ノ門三丁目25番2号 虎ノ門E Sビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: COPPER MICROPARTICLE DISPERSION

(54) 発明の名称: 銅微粒子分散体

(57) Abstract: The present invention relates to a copper microparticulate dispersion containing copper nanoparticles A, a modified cellulose B, and a dispersion medium C, wherein: the average particle diameter of the copper nanoparticles A is 50 nm to 350 nm; the content of the modified cellulose B in the copper microparticulate dispersion is 2500 mass ppm or less; the modified cellulose B is an anion-modified cellulose fiber having a modification group; and the modification group is one or more selected from the group consisting of (a) a hydrocarbon group and (b) a polymer group. The present invention also relates to a method for producing a bonded body using the copper microparticulate dispersion.

(57) 要約: 本発明は、銅ナノ粒子Aと、改質セルロースBと、分散媒Cとを含有する銅微粒子分散体であって、該銅ナノ粒子Aの平均粒径が50nm以上350nm以下であり、該銅微粒子分散体中の該改質セルロースBの含有量が2500質量ppm以下であり、該改質セルロースBが、修飾基を有するアニオン変性セルロース繊維であり、該修飾基が、(a)炭化水素基及び(b)ポリマー基からなる群から選ばれた1種以上である、銅微粒子分散体、及び該銅微粒子分散体を用いる接合体の製造方法に関する。

WO 2024/190721 A1